06.5 Фазовая однородность керамических материалов на основе Si₃N₄, изготовленных методом электроимпульсного плазменного спекания

© П.Д. Дрожилкин, К.Е. Сметанина, Л.С. Алексеева, М.С. Болдин, М.М. Востоков, К.О. Каразанов, А.А. Мурашов, П.В. Андреев

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия E-mail: andreev@phys.unn.ru

Поступило в Редакцию 29 декабря 2021 г. В окончательной редакции 3 февраля 2022 г. Принято к публикации 3 февраля 2022 г.

Методом послойного рентгенофазового анализа исследуются керамики, полученные электроимпульсным плазменным спеканием порошковых композиций на основе Si₃N₄. Продемонстрирован эффект диффузии углерода в поверхностные слои спекаемой керамики с графитовой пресс-формы. Показана однородность фазового состава керамики по глубине образца. На основе этого сделан вывод о равномерном распределении температурного поля внутри спекаемого образца.

Ключевые слова: нитрид кремния, керамика, электроимпульсное плазменное спекание, рентгенофазовый анализ.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.08.52358.19122

Керамика на основе нитрида кремния (Si₃N₄) обладает высокими физико-механическими характеристиками: прочностью, твердостью, а также коррозионной стойкостью и тугоплавкостью [1].

Из-за ковалентной природы связей в Si₃N₄ диффузионные процессы при спекании малоинтенсивны, поэтому получение керамик из чистого Si₃N₄ затруднено [2]. Для решения данной проблемы применяются спекающие добавки различного состава, например система Y₂O₃-Al₂O₃ [3]. В процессе спекания фаза α -Si₃N₄ растворяется в фазе спекающей добавки, а затем кристаллизуется в форме β -Si₃N₄. Интенсивностью этого перехода можно управлять, изменяя долю и состав спекающей добавки, а также условия спекания [4].

Для получения мелкозернистых керамик становится более популярным метод электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) [5]. Высокая скорость нагрева провоцирует перегрев поверхности и появление температурного градиента внутри заготовки, что может привести к неоднородному протеканию процесса спекания. Было показано, что в процессе ЭИПС может происходить интенсивная диффузия углерода с графитовых деталей пресс-формы в глубь образца, что приводит к появлению углеродсодержащих фаз вблизи поверхности образца [6,7].

Цель настоящей работы состоит в исследовании однородности фазового состава керамик на основе Si₃N₄, спеченных при различных температурах. Наличие фазовой неоднородности позволит сделать вывод о присутствии температурного градиента внутри керамической заготовки в процессе спекания и влиянии диффузии углерода с графитовых деталей пресс-формы. В качестве исходного материала выступал промышленный порошок Si₃N₄ (чистота 99.6%, 90 wt% α -Si₃N₄ + 10 mass% β -Si₃N₄, дисперсность < 5 μ m, Alfa Aesar, Германия). Спекающая добавка Y₂O₃-Al₂O₃ (в мольном соотношении 3:5) была внесена в исходный порошок Si₃N₄ в форме прекурсора в количестве 5 и 10 mass% (образцы № 1 и 2 соответственно) в пересчете на оксид [8].

Спекание порошковых смесей осуществлялось на установке Dr. Sinter model SPS-625 (SPS Syntex, Япония) в графитовой пресс-форме с внутренним диаметром 12 mm. Скорость нагрева до температур спекания 1880 и 1710°С для образцов № 1 и 2 соответственно составляла 100°С/тіп. Величина приложенного одноосного напряжения составляла 70 MPa. Относительная плотность керамических образцов, измеренная методом Архимеда, была равна 99 и 96% соответственно.

Исследования микроструктуры керамик проводились на микроскопе JEOL JSM-6490. В микроструктуре образца № 1 явно различимы вытянутые зерна β -фазы Si₃N₄ до 5 μ m в длину. В тройных стыках зерен видны поры размером не более 0.1 μ m.

В микроструктуре образца № 2 кроме вытянутых зерен фазы β -Si₃N₄ присутствуют равноосные зерна, вероятно, α -Si₃N₄. Между зернами различима фаза спекающей добавки толщиной ~ 0.1–0.2 μ m, а также поры размером до 0.5 μ m.

Начальная высота образцов составляла 4 mm. Поверхность спеченных образцов подвергалась последовательной механической шлифовке алмазными дисками на станке Struers Secotom-10. Контроль высоты образцов проводился с помощью микрометра.



Участки дифрактограмм образцов No 1 (a) и 2 (b) в зависимости от толщины удаленного слоя.

Рентгенодифракционные эксперименты проводились на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu, Япония) (Cu K_{α} , $\lambda = 1.54$ Å). Условия съемки были следующими: геометрия Брэгга–Брентано, "режим широкой щели", диапазон углов $2\theta = 15-70^{\circ}$, шаг сканирования 0.04°, время экспозиции 2 s.

Согласно проведенным оценкам, ослабление интенсивности рентгеновского излучения CuK_{α} в Si₃N₄ в *е* раз происходит на глубине около 40 μ m. Толщина удаленного слоя на каждом этапе составляла не менее 60 μ m для того, чтобы можно было исследовать слой, который заведомо не вносил вклад в результат на предыдущем этапе.

Качественный фазовый анализ проводился в ПО Diffrac.EVA (Вгикег, Германия) с использованием данных банка PDF-2 (2012). Количественный фазовый анализ выполнялся методом Ритвельда в ПО Diffrac.TOPAS (Вгикег, Германия) с использованием сif-файлов банка ICSD (2016): N 16752 (α -Si₃N₄), 8263(β -Si₃N₄), 28895 (3*C*-SiC), 42859 (14*H*-SiC). Абсолютная погрешность определения массовой доли фаз для обоих образцов методом Ритвельда не превышает 1 mass % (по предварительным экспериментам).

На рисунке представлены результаты послойного рентгенодифракционного исследования образцов № 1 и 2 в зависимости от толщины удаленного с их поверхности слоя. Первый эксперимент (0μ m) выполнен для поверхности керамики без механической обработки.

Фазовый состав поверхности образца № 1 (см. рисунок, *a*): 77 mass% β -Si₃N₄ (PDF N 01-071-0623) и 23 mass% 3*C*-SiC (PDF # 01-073-1665). Причиной образования фазы SiC на поверхности образца № 1 является диффузия углерода в глубь спекаемого образца из-за прямого контакта с пресс-формой. Наличие кремния на поверхности образца связано с перегревом поверхности. Такой перегрев привел к частичному разложению Si₃N₄ до Si с выделением азота. Известно, что разложение Si₃N₄ возможно начиная с $T > 1600^{\circ}$ C [2]. В нижележащих слоях обнаруживается только кристаллическая фаза β -Si₃N₄.

Из анализа дифрактограмм образца № 2 (см. рисунок, *b*) следует, что на необработанной поверхности кроме пиков фазы β -Si₃N₄ присутствуют пики, характеризующие фазу α -Si₃N₄ (PDF N 01-071-6479), которая не перешла в β -фазу из-за меньшей температуры спекания. На поверхности также обнаружена фаза 14*H*-SiC (PDF N 01-089-2215).

Фазовый состав поверхности образца № 2: 54 mass % α -Si₃N₄, 42 mass% β -Si₃N₄ и 4 mass % SiC. На глубине 60 μ m массовые доли α - и β -фаз Si₃N₄ равны 56 и 42 mass% соответственно. Также на этой глубине обнаруживается пик SiC (2 mass%). В более глубоких слоях в образце № 2 массовые доли фаз α -Si₃N₄ и β -Si₃N₄ не изменяются в пределах погрешности и составляют 57 и 43 mass % соответственно.

Сохранение фазового состава керамик позволяет говорить о равномерном распределении спекающей добавки и температуры по объему образцов начиная с глубины, не превышающей 140 µm.

Таким образом, в работе продемонстрировано, что при электроимпульсном плазменном спекании порошка Si₃N₄ может происходить диффузия углерода с графитовой пресс-формы, в которой спекается порошок, в поверхностные слои спекаемой керамики (менее $80-140 \,\mu$ m). Наличие кремния на поверхности образца подтверждает перегрев поверхности. Начиная с глубины порядка $80 \,\mu$ m слои керамик характеризуются однородностью соотношения фаз α - и β -Si₃N₄ в пределах погрешности, что позволяет сделать вывод об однородности распределения температуры внутри образца.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ для молодых российских ученых № МК-4584.2021.1.3.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

 L. Cao, Z. Wang, Z. Yin, K. Liu, J. Yuan, Mater. Sci. Eng. A, 731, 595 (2018). DOI: 10.1016/j.msea.2018.06.093

- [2] В.С. Урбанович, В.С. Нисс, С.В. Григорьев, Р. Klimczyk, L. Jaworska, S. Cygan, Л.В. Судник, Т.Д. Маликина, Физика и техника высоких давлений, 27 (2), 108 (2017).
- J. Zhang, W. Wang, F. Sun, W. Zhang, B. Li, M. Zhang, Process. Appl. Ceram., 15 (3), 279 (2021). DOI: 10.2298/PAC2103297Z
- [4] H. Mandal, D.P. Thompson, K.H. Jack, Key Eng. Mater., 159-160, 1 (1995).
- DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.159-160.1
- M. Tokita, *Handbook of advanced ceramics* (Academic Press, N.Y., 2013), p. 1149–1177.
 DOI: 10.1016/B978-0-12-385469-8.00060-5
- [6] E.A. Olevsky, D.V. Dudina, *Field-assisted sintering: science and applications* (Springer International Publ., Cham, 2018), p. 89–104, 354–379. DOI: 10.1007/978-3-319-76032-2
- [7] К.Е. Сметанина, П.В. Андреев, Е.А. Ланцев, М.М. Востоков, Н.В. Малехонова, Завод. лаб. Диагностика материалов, 86 (8), 38 (2020). DOI: 10.26896/1028-6861-2020-86-8-38-42
- [8] P.V. Andreev, P.D. Drozhilkin, L.S. Alekseeva, E.Ye. Rostokina, K.O. Karazanov, M.S. Boldin, S.S. Balabanov, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., **1014**, 012009 (2021).
 DOI: 10.1088/1757-899X/1014/1/012009